Roll No:-_____

(Sem- V (New Syll.)) Diploma Exam 2024 (Odd)

[Time: 3 Hours] **(Printing Technology) (Theory)** **[Full. Marks:70]**

Surface Preparation (2027502)

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य है।)
- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाई ओर अंकित किये है।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1	Answer all questions as directed. (निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें) **(2*10=20)**	**Marks**	**CO**	**BL**
a)	Bi-metal plate is made of …….. Aluminum / Copper/ Both Aluminum and Copper /None of these द्विधातु प्लेट किससे बनी होती है ..... एल्युमीनियम / कॉपर / एल्युमीनियम और कॉपर दोनों / इनमें से कोई नहीं	2	-	1
b)	PS plate are ……. working Positive/Negative/ Both Positive and Negative/ None of these पीएस प्लेट ..... काम कर रही हैं सकारात्मक/नकारात्मक/सकारात्मक और नकारात्मक दोनों/इनमें से कोई नहीं	2	-	1
c)	What type of surface texture is typically achieved through graining in printing plates? High gloss/Uniform roughness/Porous surface प्रिंटिंग प्लेटों में ग्रेनिंग के माध्यम से आमतौर पर किस प्रकार की सतह की बनावट प्राप्त की जाती है? उच्च चमक/समान खुरदरापन/छिद्रपूर्ण सतह	2	-	1
d)	In offset printing image area of the plate is……. Hydrophilic/ Oleophilic /Both Hydrophilic and Oleophilic /None of these ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट का इमेज एरिया..... है। हाइड्रोफिलिक/ओलियोफिलिक /हाइड्रोफिलिक और ओलियोफिलिक दोनों /इनमें से कोई नहीं	2	-	1
e)	…….is/are used as base substrate for Digital plate Metal/ Polyester/ Paper/ All of these ….का उपयोग डिजिटल प्लेट आधार सब्सट्रेट के रूप में किया जाता है धातु/पॉलिएस्टर/कागज/इन सभी के लिए	2	-	1
f)	Light sources used for offset plate exposure are……. Lamps Pulsed/Metal halide/ Carbon arc/ All of these ऑफसेट प्लेट एक्सपोजर के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाश स्रोत हैं.....लैंप पल्स्ड/मेटल हैलाइड/कार्बन आर्क/ये सभी	2	-	1
g)	Due to graining surface area of plate is ……. Increased /Decreased/ Same/Nothing happens	2	-	1

	ग्रेनिंग के कारण प्लेट का सतही क्षेत्रफल ..... बढ़ा / घटा / वही / कुछ नहीं हुआ			
h)	Gelatin is a …… substance. Organic /Inorganic/ Acidic/ None of these जिलेटिन एक ….. पदार्थ है। कार्बनिक / अकार्बनिक / अम्लीय / इनमें से कोई नहीं	2	-	1
i)	Defects from inadequate cleaning during plate preparation Scumming/Hickeys/Slurring/Pin hole प्लेट तैयार करते समय अपर्याप्त सफ़ाई से दोष स्कमिंग/हिकीज़/स्लरिंग/पिन होल	2	-	1
j)	Lith emulsion is made by…….. Ammonium Di chromate / Silver chloride/ Gum Arabic/ None of these लिथ इमल्शन किससे बनता है... अमोनियम डाइ क्रोमेट / सिल्वर क्लोराइड / गम अरेबिक / इनमें से कोई नहीं	2	-	1
	Group (B) (ग्रुप -बी) **Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)** **4*5=20**			
Q.2	Briefly describe CTP plate making system in surface preparation. सतह तैयारी में सीटीपी प्लेट बनाने की प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें।	4	-	2
	OR (अथवा)			
	Briefly discuss disadvantage of albumin plate making system in surface preparation. सतह तैयार करने में एल्बुमिन प्लेट बनाने की प्रणाली के नुकसान पर संक्षेप में चर्चा करें।	4	-	2
Q.3	Briefly explain screen tint in surface preparation. सतह तैयार करने में स्क्रीन टिंट का संक्षेप में वर्णन करें।	4	-	2
	OR (अथवा)			
	write short notes on the following (a) aluminum anodizing (b) offset exposure plate निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें (a) एल्युमीनियम एनोडाइजिंग (b) ऑफसेट एक्सपोज़र प्लेट	4	-	2
Q.4	Briefly explain the disadvantage of deep-etch plates in surface preparation. सतह तैयार करने में डीप-एच प्लेटों के नुकसान को संक्षेप में समझाइए।	4	-	3
	OR (अथवा)			
	Briefly describe the advantages of bi-metal plates in surface preparation. सतह तैयार करने में द्वि-धातु प्लेटों के लाभों का संक्षेप में वर्णन करें।	4	-	3
Q.5	Discuss the two illuminates is used in platemaking process. प्लेटमेकिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले दो प्रदीपकों पर चर्चा करें।	4	-	3
	OR (अथवा)			
	Briefly describe P.S plates in surface preparation. सतह तैयारी में पी.एस. प्लेटों का संक्षेप में वर्णन करें।	4	-	3

Q.6	Write the quality control aids and their application in surface preparation. गुणवत्ता नियंत्रण सहायक उपकरण और सतह तैयारी में उनके अनुप्रयोग लिखें।		4	-	3
	OR (अथवा)				
	Briefly explain the removal of work on plate in surface preparation. सतह तैयार करने में प्लेट पर से कार्य हटाने को संक्षेप में समझाइए।		4	-	3
	Group (C) (ग्रुप -सी)				
	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)	**6*5=30**	6	-	4
Q.7	Describe the wipe-on plate Making process in surface preparation. सतह तैयार करने में वाइप-ऑन प्लेट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें।				
	OR (अथवा)				
	Explain the different light sources is used in plate making process. प्लेट बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रकाश स्रोतों की व्याख्या कीजिए।		6	-	4
Q.8	Discuss the preparing layout by various methods in surface preparation. सतह तैयार करने में विभिन्न तरीकों द्वारा लेआउट तैयार करने पर चर्चा करें।		6	-	4
	OR (अथवा)				
	Write the preparing mechanicals for single color works use of pin register system in surface preparation. एकल रंग कार्यों के लिए तैयारी यांत्रिकी लिखें और सतह तैयारी में पिन रजिस्टर प्रणाली का उपयोग करें।		6	-	4
Q.9	Differentiate between bi-metals and tri-metals plates. द्विधातु और त्रिधातु प्लेटों के बीच अंतर बताइए।		6	-	4
	OR (अथवा)				
	Explain the surface plate Making process in surface preparation. सतह तैयार करने में सतह प्लेट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए।		6	-	4
Q.10	Describe the factors effected for quality control in surface preparation. सतह तैयारी में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रभावित कारकों का वर्णन करें।		6	-	4
	OR (अथवा)				
	Explain dark and continuing reaction in surface preparation. सतह तैयार करने में अंधकारमय और सतत प्रतिक्रिया की व्याख्या करें।		6	-	4
Q.11	Write the plate making troubles in surface preparation. सतह तैयार करने में प्लेट बनाने में आने वाली परेशानियों को लिखें।		6	-	4
	OR (अथवा)				
	Write short notes on the following- (a) P.S Plate (b) Deep-etch plates (c) Hybrid plates निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें- (a) पी.एस प्लेट (b) गहरी खोदने वाली प्लेटें (c) हाइब्रिड प्लेटें		6	-	4

----------*****----------